



# 鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

## H200-Soft 超软系列

### 【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

#### 应用特点：

- 柔软，可压缩性好
- 热阻抗较小
- 表面自带粘性
- 防火性能高
- 低压力下应用
- 很好的电绝缘性能和耐高温性能

#### 应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

#### 储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30°C

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

#### 保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

鸿富诚 H200-Soft 导热硅胶垫片，热空穴填料具有优良的柔软性、压缩性和自然表面粘度性能。用于填充间隙，实现加热件与冷却件之间的传热。同时具有绝缘和减震效果，可满足小型和超薄设备的设计要求，具有优良的制造性和实用性。厚度范围广，广泛应用于电子产品中。

#### 产品性能

| NO.  | 参数              | 单位       | 测试方法           |
|------|-----------------|----------|----------------|
| 颜色   | 浅蓝色             | ---      | 目视             |
| 厚度   | 0.8~3           | mm       | ASTM D 374     |
| 硬度   | 20±5            | Shore 00 | ASTM D 2240    |
| 密度   | 2.4±0.5         | g/cc     | ASTM D 792     |
| 拉伸强度 | ≥0.15           | Mpa      | ASTM D 412     |
| 延伸率  | ≥70             | %        | ASTM D 412     |
| 压缩比  | ≥50<br>(@50psi) | %        | ASTM D 695     |
| 阻燃等级 | V-0,5V          | ---      | UL-94          |
| 使用温度 | -50~180         | °C       | IEC 60068-2-14 |

#### 热学特性

|      |                      |                      |             |
|------|----------------------|----------------------|-------------|
| 导热系数 | 2.0±0.3              | W/m·K                | ASTM D 5470 |
| 热阻   | ≤0.7<br>(@20Psi/1mm) | °Cin <sup>2</sup> /W | ASTM D 5470 |

#### 电学特性

|       |                  |       |            |
|-------|------------------|-------|------------|
| 击穿电压  | ≥8               | KV/mm | ASTM D 149 |
| 体积电阻率 | ≥10 <sup>8</sup> | Ω·cm  | ASTM D 257 |
| 介电常数  | ≥2               | @1MHz | ASTM D 150 |
| 介质损耗  | ≤0.1             | @1MHz | ASTM D 150 |

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

